

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技

证券代码：688035

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(线上会议、策略会)
参与单位名称及人员姓名	中信证券策略会
时间	2026年5月7日-5月8日
地点	券商策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于杰 董事会办公室总监：战世能
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简单介绍一下公司主营业务、各业务板块占比情况以及相关客户情况？</p> <p>答：公司主营电子封装材料，产品广泛应用于集成电路、智能终端、新能源、高端装备四大应用领域。其中集成电路产品包括：固晶系列产品（含固晶胶、固晶膜）、UV膜系列产品（含减薄膜、划片膜产品）、热界面材料（含导热垫片、导热凝胶、相变化材料、液态金属等）以及底部填充胶、AD胶等先进封装材料，主要客户包括国内主流芯片设计公司、封测企业以及组装厂；智能终端涉及产品众多，普遍应用于手机、耳机、Pad、笔电、智能手表、智能眼镜、车载电子、机器人等终端产品及相关领域，主要客户包括国内外头部智能终端品牌商以及相关</p>

代工厂、国内部分头部汽车品牌商以及相关供应链厂商等；新能源板块公司主要涉及锂电和光伏两部分业务，其中锂电主要涉及材料为应用于动力电池和储能电池电池包内部的结构导热材料，目前该业务公司处于行业领先地位，产品主要供给宁德时代、比亚迪、国轩、亿维等国内头部电池厂商，光伏业务主要产品为叠瓦导电胶、基于00B技术的UV胶以及少量其他光伏封装材料；高端装备产品主要应用于汽车轻量化的结构粘接、轨道交通、矿山机械等领域。

根据2025年度数据，公司各业务板块均呈现增长态势，其中集成电路板块占总收入的16.2%；智能终端板块占总收入的24.8%；新能源板块占总收入的52.3%；高端装备板块占总收入的6.7%。从近两年以及未来发展趋势来看，集成电路和智能终端板块增速更为明显，业务占比呈明显提升态势，新能源板块占比将呈现下降的趋势，高端装备板块增速相对平稳。

**2、请具体介绍一下公司热界面材料业务情况？**

答：公司导热界面材料目前已经成为公司重要的支柱业务之一，在收入、利润方面均有较大的贡献。公司导热界面材料主要由深圳德邦界面、苏州泰吉诺两个子公司负责，两个子公司在产品应用定位上略有区别。深圳德邦界面产品广泛应用于消费电子、汽车电子、存储、通讯、新能源等领域，并在汽车电子、存储等高附加值领域持续突破；泰吉诺产品主要应用于服务器领域，同时也应用于消费电子、汽车电子、通讯等领域。

**3、请介绍一下泰吉诺产品的情况？**

泰吉诺主要产品包括高性能导热硅脂、导热凝胶、高导热凝胶垫片、相变材料及液态金属导热材料等，广泛应

用于数据中心（AI 服务器/GPU）、新能源汽车（电池/BMS/电控）、消费电子等领域。在 AI 领域，其高性能导热凝胶垫片、相变材料及液态金属材料，广泛应用于 AI 服务器、光模块、GPU/ASIC 芯片的散热，可有效应对高热流密度，保障核心算力部件稳定运行与性能释放，是保障 AI 基础设施热管理的核心组成部分。

#### **4、公司液体金属产品的主要应用情况？**

答：液体金属材料是公司在导热界面材料领域布局的重要材料之一，具体产品包括：液态金属片和复合液态金属膏等。针对浸没式液冷服务器散热需求，公司已开发出适配特定环境的液态金属片产品，解决了传统硅脂、相变化材料在特定环境下的可靠性问题；在冷板式液冷应用中，针对千瓦级 GPU/CPU 等高功耗芯片面临的传统硅脂、相变材料导热瓶颈问题，公司已开发出复合液态金属膏作为升级替代方案；在消费电子领域中，公司液态金属材料可应用于高性能游戏本和游戏机散热系统，满足消费电子终端设备的高导热热管理需求。

#### **5、请介绍一下公司液体金属产品在英伟达最新的 Rubin 架构中的应用？**

答：公司尚不清楚英伟达 Rubin 架构是否确定采用液体金属导热方案，公司液体金属产品目前未在该客户有出货。公司会持续关注行业发展方向，关注 AI 领域技术升级带来的市场机会，持续为客户提供高可靠性解决方案。

#### **6、请介绍公司智能终端业务的整体情况，后续发展动力？**

答：公司相关材料可广泛适配手机、耳机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑、车载电子、平板显示等各类智能终端产品。

目前公司在耳机端已形成稳固份额优势，尤其在 TWS 无线耳机领域表现亮眼，依托声学模组密封、结构粘接等环节的技术优势，已在国内外头部客户的供应链中占据较高市场份额，成为该细分领域的核心供应商之一；智能手机领域，以 LIP0 超窄边框屏幕封装技术为代表的全新应用场景持续落地突破，整体配套份额稳步提升；车载电子业务实现多品类批量导入、规模快速放量；偏光片相关应用拓展节奏加快，业务已进入快速增长通道。

整体来看，产品核心竞争力持续强化、新兴应用场景不断突破、各终端品类市场份额稳步提升，是拉动公司智能终端业务持续稳健增长的核心驱动力。

**7、请介绍公司新能源板块业务的整体情况，近期原材料涨价对公司的影响？**

答：随着下游新能源汽车产销稳步增长、储能行业加速普及渗透，公司新能源应用材料出货量保持高速增长，行业市场份额维持稳健水平。

近期中东战争导致原油价格大幅上涨，受原油价格的影响，多元醇、异氰酸酯等公司新能源板块主要原材料价格也出现不同程度的上涨，原材料的涨价短期内会导致公司相关产品的成本有所上升，毛利有所下降，公司也在努力采取各种措施，开源节流，尽可能将影响降低到最小区间。

**8、请介绍一下公司叠瓦导电胶产品的应用及客户情**

	<p>况？</p> <p>答：公司的光伏叠晶材料可以为光伏电池提供粘接、导电、降低电池片间应力等功效，是实现光伏叠晶封装工艺、实现高导电性能、高可靠性的关键材料之一。</p> <p>公司叠瓦导电胶是多年稳定出货的成熟产品，公司也一直是该产品的主要供应商。目前公司该产品主要供给北美客户，应用于高效屋顶光伏领域，并处于稳定增量的过程中，但其收入规模占公司整体收入比例较低。</p>
附件清单（如有）	无